

# プリント配線板市場に関する調査結果 2009

## 【調査要綱】

矢野経済研究所では次の要綱にてプリント配線板市場に関する調査を実施した。

1. 調査期間:2009年7月～10月
2. 調査対象:日本国内の有力プリント配線板メーカーおよび関連協会等
3. 調査方法:当社専門研究員による直接面談、ならびに各種文献調査を併用

### <プリント配線板市場とは>

電子機器に搭載され、部品の配線を担う電子回路を形成するボードのこと。電子機器の高性能化に伴い搭載部品が増加、配線数が増えることにより、配線が微細化しプリント配線板の層数も増加、多層板となる。

本調査ではリジッドプリント配線板(片面プリント配線板、両面プリント配線板、多層プリント配線板、ビルドアップ基板)およびモジュール基板を対象とする。

## 【調査結果サマリー】

### ◆ 2008年プリント配線板国内生産額は前年比86%の1兆1,918億円

2008年のプリント配線板国内生産額は前年比86%の1兆1,918億円であった(社団法人日本電子回路工業会データより引用)。2008年上期は前年同期を上回るほど好調であったが、2008年秋以降の世界的な不況、および円高による輸出不振の影響により、2001年のITバブル崩壊以来のマイナス成長となった。

- ◆ 片面プリント配線板は製品価格低下圧力から国内製造が減少し、  
海外生産が更なる増加傾向に
- ◆ 両面プリント配線板・低多層プリント配線板は海外生産が進行、価格競争力の強い海外メーカー品から高品質な日系メーカー品に需要の戻りも見られる
- ◆ ビルドアップ基板で低多層ビルドアップは海外生産、  
8層・10層等の高付加価値製品は国内生産、自動車用途採用拡大に期待
- ◆ 高多層板は需要増加で海外メーカー品による低価格化が進行
- ◆ 2009年プリント配線板国内生産額は前年比92%の1兆964億円を見込む  
2009年のプリント配線板国内生産額は前年比92%の1兆964億円を見込む。在庫整理が一巡した影響から2009年3月～4月頃から徐々に需要が戻りつつあるが、本格的な景気回復とはなっておらず、年内の需要増加は難しいと考える。

### ◆ 資料体裁

資料名：「プリント配線板市場の現状と将来展望 2009年版」  
 発刊日：2009年10月30日  
 体裁：A4判163頁  
 定価：99,750円（本体価格95,000円 消費税等4,750円）

### ◆ 株式会社 矢野経済研究所

所在地：東京都中野区本町2-46-2 代表取締役社長：水越 孝  
 設立：1958年3月 年間レポート発刊：約250タイトル URL: <http://www.yano.co.jp/>

本件に関するお問合せ先（当社HPからも承っております <http://www.yano.co.jp/>）

㈱矢野経済研究所 営業本部 広報・PRグループ TEL：03-5371-6912 E-mail:[press@yano.co.jp](mailto:press@yano.co.jp)

本資料における著作権やその他本資料にかかる一切の権利は、株式会社矢野経済研究所に帰属します。  
 本資料内容を転載引用等されるにあたっては、上記広報・PRグループ迄お問合せ下さい。

## 【 調査結果の概要 】

### 1. 市場概況

2008年のプリント配線板国内生産額は前年比86%の1兆1,918億円(社団法人日本電子回路工業会データより引用)であった。2001年のITバブル崩壊以降の国内生産額は増加傾向が、8年ぶりのマイナス成長となった。2008年上期までは需要が順調に推移していたが、2008年秋以降の世界不況の影響により同年下期以降プリント配線板需要が激減し、通年ベースでも国内生産額の減少となった。

### 2. 種類別プリント配線板市場動向

#### 2-1. 片面プリント配線板

中国製品等が増加し、価格競争が激化した。その結果、供給メーカーが減少、需要と供給バランスが均衡し、価格が適正化されつつある。なお、片面プリント配線板の国内製造は自動車用途など一部の需要向けに限られ、依然として減少傾向にあり、海外での生産が中心となる。

#### 2-2. 両面プリント配線板・低多層プリント配線板(4~6層)

片面プリント配線板の製造と同様、製品価格低下圧力の高まりから両面プリント配線板の国内生産は減少傾向にあるが、海外OEM生産を進める日系メーカーは両面板・低多層プリント配線板の出荷を伸張させている。

#### 2-3. ビルドアップ基板

4層や6層の低多層ビルドアップ基板は海外生産が進行しており、一概に全てのビルドアップ基板が高付加価値製品とは言えなくなりつつある。ただし、携帯電話のハイエンド機種に使用されるような8層や10層は、製造技術レベルが高く、日系メーカーの得意とする高付加価値製品である。また、自動車用途にもビルドアップ基板の採用が拡大していることから、信頼性の高い基板の製造を得意とする日系メーカーは注力しており、国内製造が継続している。

#### 2-4. 高多層板

20層以上の高多層板は製造技術レベルが高く、高付加価値製品である。高多層板はサーバーやルーターなどのIT関連産業機器への搭載の他、携帯電話用の基地局向け等に使用されるが、携帯電話の世界的普及に伴う需要増加と共に、コスト競争力の強い中国製品が市場に参入してきており、低価格化が進行している。

#### 2-5. モジュール基板

アプリケーションの高機能化に伴い、マザーボードと切り離し、GPSや無線LANなどの新機能を搭載したモジュール基板の需要が増加している。部品実装技術など、非常に高度な技術を要することから、日系メーカーに対する需要増加を期待できる市場である。

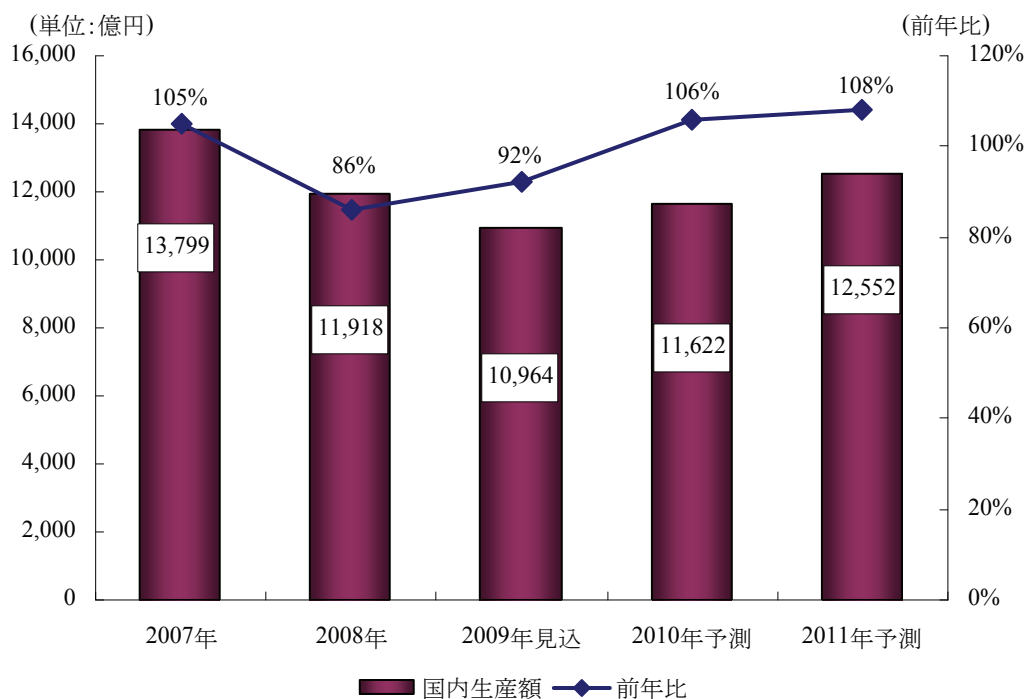
### 3. 将来展望

2009年のプリント配線板国内生産額は前年比92%の1兆964億円を見込む。2008年秋以降の不況の影響から徐々に回復、同年3月~4月頃から需要が戻り始めてはいるものの、需要全般における力強い回復は難しいと考える。

今後の日系メーカーは、高品質を求められる自動車用途や、製造技術レベルの高いサーバーやルーターなどに使用される高多層板、携帯電話などの小型電子機器に求められる高密度配線を使用したビルドアップ基板とモジュール基板向けの出荷に注力していくものとする。これは、これらの需要が今後も継続的に伸張することに加え、日系メーカーの強みを活かせる点が背景にある。

ただし、コスト競争力の強い中国製品等の影響による製品価格低下圧力が継続的に予想されるため、日系メーカーによる国内プリント配線板生産額は、大幅な成長を見込むことは難しく、微増傾向に留まるものと思われる。従って、2010年のプリント配線板国内生産額は前年比106%の1兆1,622億円、2011年は同108%の1兆2,552億円と予測する。

図表 1. プリント配線板の国内生産額推移



(単位：億円)

	2007年	2008年	2009年見込	2010年予測	2011年予測
国内生産額	13,799	11,918	10,964	11,622	12,552
前年比	105%	86%	92%	106%	108%

注 1: 国内生産額ベース

注 2: 2007～2008年実績値は社団法人日本電子回路工業会(JPCA)より引用、2009年以降は矢野経済研究所推計値

注 3: 見込は見込値、予測は予測値